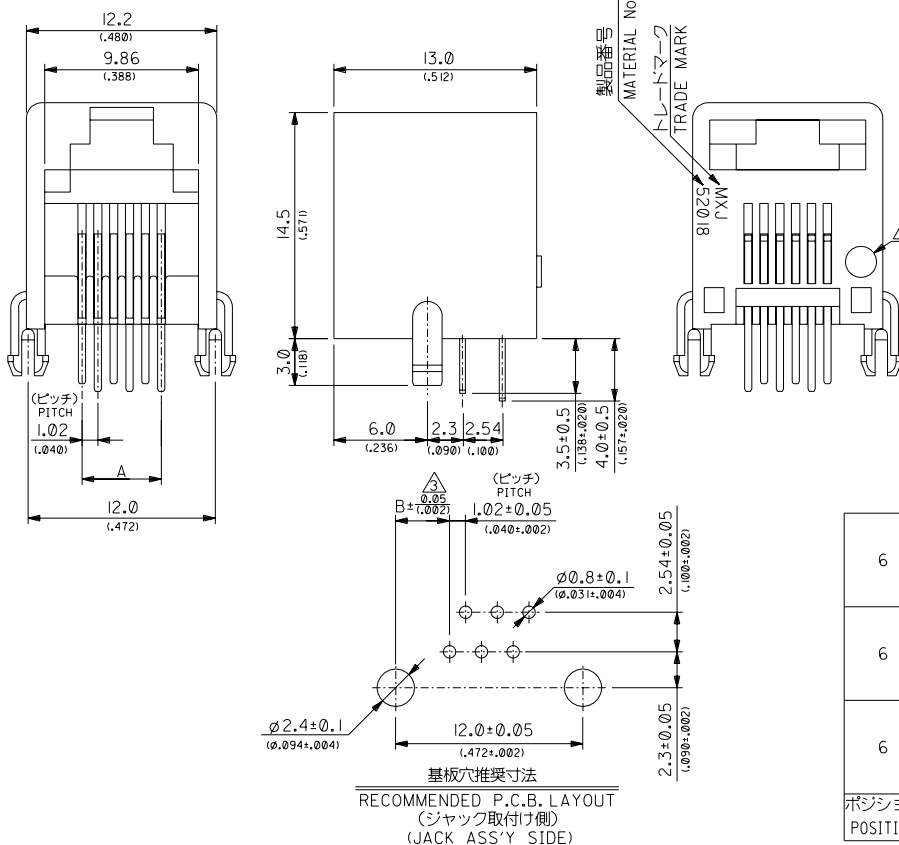


DWG. NO. SD-52018-003

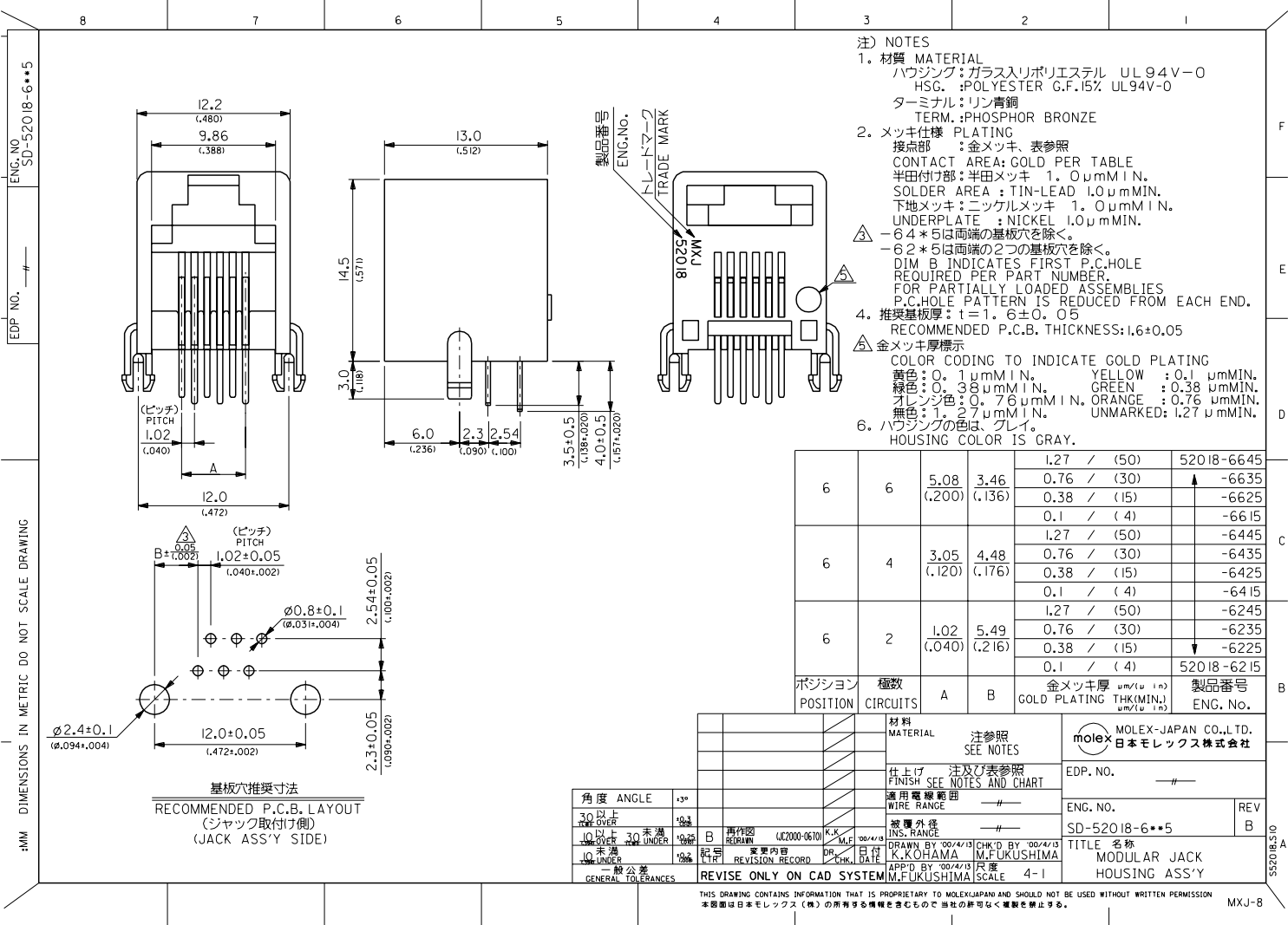


- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM. PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0μmMIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0μmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
△ -6.2*6は両端の2つの基板穴を除く。
-6.2*6は両端の2つの基板穴を除く。
DIM B INDICATES FIRST P.C.HOLE
REQUIRED PER PART NUMBER
FOR PARTIALLY LOADED ASSEMBLIES
P.C.HOLE PATTERN IS REDUCED FROM EACH END.
 - 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
 - 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1μmMIN. YELLOW: 0.1 MICROMETER MINIMUM.
緑色: 0.38μmMIN. GREEN: 0.38 MICROMETER MINIMUM.
オレンジ色: 0.76μmMIN. ORANGE: 0.76 MICROMETER MINIMUM.
無印: 1.27μmMIN. UNMARKED: 1.27 MICROMETER MINIMUM.
 - ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
 - 本製品は52018-6**5の船フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-6**5.

6	6	5.08 (.200)	3.46 (.136)	1.27 / (50)	52018-6646
				0.76 / (30)	▲ -6636
6	4	3.05 (.120)	4.48 (.176)	0.38 / (15)	-6626
				0.1 / (4)	-6616
				1.27 / (50)	-6446
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	0.76 / (30)	-6436
				0.38 / (15)	-6426
				0.1 / (4)	-6416
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	1.27 / (50)	-6246
				0.76 / (30)	-6236
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	0.38 / (15)	▼ -6226
				0.1 / (4)	52018-6216
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	A	B	金メッキ厚 μm(μMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) μm(μMIN.)	製品番号 MATERIAL No.

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

DO NOT SCALE DRAWING		E304NO. DRWN: CH/K: APPR:		E33NO. DRWN: CH/K: APPR:		E32NO. DRWN: CH/K: APPR:		E31NO. DRWN: CH/K: APPR:		新製作成 RELEASED E30NO. J2004-4221 DRW/M.NAGATA '04/05/14 CHK/K. TOJO '04/05/14 APPR/M.SASAO '04/05/14		MATERIAL 材料 注参照 SEE NOTES		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE 4:1		MODEL NO. 52018-6**6		DIMENSIONS: 20° 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° mm INCH mm ONLY		SHT REV	
												FINISH 仕上げ 注及び表参照 SEE NOTES AND CHART		10 UNDER 未満 1.00		DRAWN BY & DATE M.NAGATA '04/05/14		TITLE: MODULAR JACK HOUSING ASS'Y -LEAD FREE-		22° 15° 10° 5°		22° 15° 10° 5°	
												WIRE RANGE 適用電線範囲		10 OVER 1.00以上 30 UNDER 未満		CHECKED BY & DATE K.TOJO '04/05/14		MOLEX MOLEX INCORPORATED		MATERIAL NO. SD-52018-003		SHEET NO. 1 OF 1	
												INS. RANGE 被覆外径		30 OVER 1.00以上		APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/05/14		CAD FILENAME SD-52018-003.S01		DRAWING NO. SD-52018-003		SIZE B	
												ANGLE 角度		±3°				DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		EN-02J(097) MXJ-54			



- 注) NOTES
1. 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
 2. メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 半田メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN-LEAD 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0µmMIN.
 3. △ -6.4*は両端の基板穴を除く。
-6.2*は両端の2つの基板穴を除く。
DIM B INDICATES FIRST P.C.HOLE
REQUIRED PER PART NUMBER.
FOR PARTIALLY LOADED ASSEMBLIES
P.C.HOLE PATTERN IS REDUCED FROM EACH END.
 4. 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
△ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. YELLOW: 0.1µmMIN.
青色: 0.38µmMIN. GREEN: 0.38µmMIN.
緑色: 0.76µmMIN. ORANGE: 0.76µmMIN.
無色: 1.27µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
 6. ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.

6	6	5.08 (.200)	3.46 (.136)	1.27 / (50)	52018-6645
				0.76 / (30)	-6635
6	4	3.05 (.120)	4.48 (.176)	0.38 / (15)	-6625
				0.1 / (4)	-6615
				1.27 / (50)	-6445
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	0.76 / (30)	-6435
				0.38 / (15)	-6425
				0.1 / (4)	-6415
				1.27 / (50)	-6245
POSITION		CIRCUITS		A	B
				金メッキ厚 µm/(µ in)	
				GOLD PLATING THK(MIN.) µm/(µ in)	
				製品番号	
				ENG. No.	

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)

角度 ANGLE	+30	材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上 OVER	100	仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	
10以下 UNDER	100	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	EDP. NO. —
10以下 UNDER	100	被覆外径 INS. RANGE	—	ENG. NO. SD-52018-6**5
10以下 UNDER	100	記号 変更内容	日付	REV B
10以下 UNDER	100	記号 変更内容	日付	TITLE 名称
10以下 UNDER	100	記号 変更内容	日付	MODULAR JACK HOUSING ASS'Y
10以下 UNDER	100	記号 変更内容	日付	SCALE 4-1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 MXJ-B

ENG. NO. SD-52018-6**5
EDP. NO. —

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

F
E
D
C
B
A